

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、东北证券、申万菱信基金等多家机构
时间	2024年10月16日 10:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 丁国兴 董事、总经理 赵奇 财务负责人、董事会秘书 王伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>二、现场交流与问答：</p> <p>问题1：公司在模拟IC这块的布局战略和竞争优势是什么？</p> <p>回复：在模拟IC芯片方面，公司聚焦于国内稀缺的高性能、高功率、高可靠性BCD技术方向。上半年公司新发布四个车规级平台，其中数模混合嵌入式控制芯片制造平台填补了国内驱动+控制集成化芯片技术的空白；高边智能开关芯片制造平台，是国内稀缺的驱动+开关单芯片集成技术平台；高压BCD 120V平台是国内稀缺的高压电源管理平台，满足了高电压和高可靠性的车规和工业应用需求；高压SOI BCD平台对应的技术位于国内领先水平，为国内首个12英寸SOI BCD平台，也是高压高集成度低成本电源管理芯片平台。同时，公司携手多个芯片设计客户，获得国内多个车企和Tier1项目定点。</p> <p>同时，公司不断拓展新产品线，计划推出高可靠性、高性能专用MCU平台；不断拓宽业务领域，全面布局高增长的AI高速服务器领域，为AI服务器</p>

电源，AI集群通信等多个AI系统提供完整的电源管理芯片和模组的代工服务，为产品公司打造国内AI服务器电源代工方案提供技术支撑和大规模高质量交付保障。

问题2：碳化硅的良率和未来降本路径如何？

回复：作为SiC模块领域的领军企业，公司在SiC领域持续保持技术创新。公司用了三年时间，迭代了三代SiC MOS产品，最新第三代1200V SiC MOS在主要性能指标上已具备国际领先水平，已在汽车主驱应用量产。

在过去三年，凭借深厚的研发经验，公司SiC产品的良率已经有了大幅提升。公司6英寸SiC产品的CP良率已经达到94%左右，处于全球领先水平。正因为公司SiC产品在良率上的优异表现，公司上半年SiC MOS收入同比增长超300%，作为公司的第二增长曲线成为公司重要的收入来源之一。

由于碳化硅在能源转换效率等方面有更好的性能，为了更好的扩大SiC产品的应用市场，需要匹配更优的性价比。碳化硅在未来的降本路径上主要通过以下三个技术方向的改变：第一，尺寸从6英寸到8英寸转变。由于面积扩大、单片上附载芯片数量增加，从而使单片SiC晶圆产品单价的提升大于其单片生产成本的增加。第二，器件类型从平面型转向沟槽型，其目的是使每颗芯片的面积更小，从而在单片晶圆上产生更多的芯片，进而降低单颗芯片的单价。第三，碳化硅产业链从衬底、外延、器件制造、模块封装等各环节良率的进一步提升，进而降低成本。

问题3：公司各下游的收入占比？今年下半年和明年的景气度如何？

回复：2024年上半年，公司营业收入的持续稳定增长主要受益于新能源及消费市场的温和复苏。公司产品在车载领域的收入占比为48%，在消费领域的占比为34%。其中车载领域营收环比增加3.08亿元，增幅超30%；消费领域营收环比增加2.57亿元，增长37%，同比增幅107%。

2024年前三季度，公司实现营收约45.5亿元，同比增长18.68%，与上年同期相比增加约7.2亿元。归母净利润预计为-6.8亿元，同比减亏约49.73%，相比上年同期减亏约6.8亿元。EBITDA预计为16.6亿元，同比增长近一倍。业绩增长的主要原因包括SiC和12英寸硅基晶圆等新产品的快速转化，以及新能源车和消费市场的回暖，大客户项目定点增加带动产线利用率大幅度提升，接近满载。其中，公司SiC、12英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和量产，以SiC MOSFET芯片及模组产线组成的第二增长曲线和以高压、大功率BCD工艺为主的模拟IC方向的第三增长曲线，也均实现快速增长。

2024年第三季度，公司营业收入约为16.7亿元，创下历史新高。同时，第三季度毛利率已实现单季度转正约为6%，显示出公司盈利能力的逐步改善。预计今年下半年和明年公司将继续保持高增长态势。

问题4：过去一年电动车和光伏的量仍在持续增长，但由于去库存影响，也伴随着降价的压力，公司对未来行业景气度如何展望？

回复：公司对于行业景气度情况持谨慎乐观态度。随着AI技术的持续落地与普及势必将带动手机、白色家电等消费市场的增长，为公司带来新的增长机遇。中国新能源汽车市场整体快速增长，对燃油车排放标准的限制将进一步推动新能源车的市场份额提升。新能源风光储市场已逐渐恢复，并且随着政策的持续加码和有效需求的逐步释放，市场规模有望进一步扩大。同时，受益于国内市场增长和国产替代的双重驱动，整体需求有望持续向好。这是公司保持乐观的原因。

另一方面，公司也看到了市场供给的增加带来的市场竞争的加剧。目前市场的竞争主要集中在对芯片性能要求较低的中低端产品上。在中高端产品上，市场呈现集中化的情况，其需求主要集中在2~3家技术、生产能力领先的企业中，从而其对应的产品价格能相对平稳。

目前，公司的产品主要应用于中高端领域，同时公司将继续通过强大的技术优势和规模优势来应对市场的波动和产品的竞争，通过技术的不断迭代创新，提供客户更优的产品和技术，从而继续扩大市场份额。

问题5：公司如何考虑芯联越州的收购事项？

回复：第一，国家对于优化资源配置，支持科技企业高水平发展，推动科技型企业高效实施并购重组等各项政策的强力支持，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，以及建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”，进一步促进了公司对收购越州的信心。第二，芯联越州已前瞻性布局SiC MOSFET、VCSEL（GaAs）以及高压模拟IC等更高技术平台的研发和生产能力。目前，芯联越州已拥有IGBT和硅基MOSFET的产能为7万片/月，以及SiC MOSFET产线，是非常优质的资产，富有盈利潜力。第三，全资控股芯联越州，一方面可一体化管理上市公司母公司10万片/月和芯联越州7万片/月的8英寸硅基产能，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现更深层次的整合，有效降低管理复杂度，进一步提升上市公司执行效率；更为重要的是，上市公司可以利用积

累的技术优势、客户优势和资金优势，重点支持SiC MOSFET、高压模拟IC等更高技术产品和业务的发展，更好地贯彻上市公司的整体战略部署，把握汽车电子领域碳化硅器件快速渗透的市场机遇，持续推进产品平台的研发迭代。

问题6：市场上功率类产品的封装市场竞争加剧，如何看待这种现象？公司在封测市场上有何优势？

回复：市场发展的规律本身便遵循从蓬勃进入到激励竞争再到优胜劣汰的过程。在这个过程中，需要市场的充分竞争后，才能回归合理竞争的态势。

由于模拟类芯片成品对芯片制造和封装之间的要求更紧密，基于客户对模块出货的整体需求，为了减少沟通壁垒和降低对产品性能的影响，公司建立了车规级的模块封装工厂，确保从芯片到模块产品的一站式代工服务符合客户的要求。同时，规模效应下合理的成本控制对封装厂非常重要。目前公司的模块封装能力已达33万块/月，是国内模拟类规模最大的晶圆制造和模块封装的代工平台。上半年公司已完成装机59万套，公司的功率模块出货量位居中国市场前列。根据NE时代发布的2024年上半年新能源乘用车功率模块装机量数据，公司排名国内第四。

基于公司各环节的有效沟通、性能的互相配合以及产线的规模化效应，公司模组封装的营业收入已实现了快速增长，未来将继续保持增长的态势。

问题7：公司对于后续发展及投资的节奏是如何安排的？

回复：在后续发展和投资节奏上，公司目前已从快速扩大规模向提升盈利能力为主调整；在业务上，持续保持研发投入和技术迭代，不断创新，赶超国际领先水平。目前对公司经营业绩的影响主要因素为固定资产折旧占比较大，因而在未来的2~3年，公司计划以平缓有序的方式重点投资三期12英寸硅基晶圆及SiC晶圆项目。

未来，公司将通过：1) 研发迭代和技术、产品创新，调整产品结构提升收入；2) 平稳的资产投入，减轻折旧压力；3) 持续进行成本改善和控制，精益化生产管理，提升产品盈利能力；4) 实施重组芯联越州，整合优质资产等手段和措施，不断提升公司的经营质量。反映在业绩表现上，公司发布的三季度业绩预告也显示，第三季度单季度毛利率已实现转正，公司盈利能力持续向好。

附件清单 (如有)	无
日期	2024年10月16日